下载日志已记录，仅供内部参考

2026年09月22日

行业周报

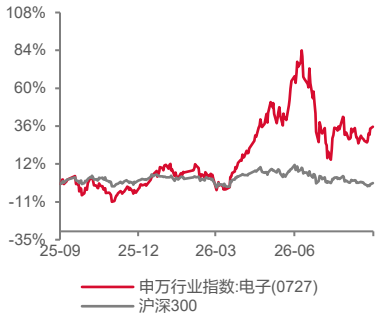
电子

标配

华为昇腾960提前就绪，长鑫科技G5平台量产落地

——电子行业周报2026/9/14-2026/9/20

证券分析师
方霁 S0630523060001
fangji@longone.com.cn
联系人
方逸洋
fyy@longone.com.cn



相关研究

1.三大厂商同周发布折叠新机，台积电8月营收创历史新高——电子行业周报2026/9/7-2026/9/13
2.全球电子厂商Q2业绩整体向好，关注9月消费电子旺季催化——电子行业8月月报
3.兆易创新（603986）：利基DRAM产能或增长，产品不断迭代增强长期竞争力——公司简评报告

投资要点：

- **电子板块观点：华为宣布昇腾960系列芯片已提前完成研发准备，整体性能翻倍，并首次披露昇腾970、980路线图及业界首个NPO光引擎超节点。长鑫科技宣布第五代DRAM工艺技术平台（G5平台）正式量产，通过四重曝光技术，内存阵列的有源区半间距微缩至11.95纳米，接近全球最顶尖的内存量产平台制程。半导体需求在AI驱动下持续旺盛，三季度报告或继续保持高增长趋势，目前全球半导体行业估值整体相对较高，但市场资金火热，可以继续关注。建议逢低关注AI算力、存储、光模块及光芯片、算力PCB、AIoT等产业链环节，同时关注半导体设备、零部件、材料、先进封装及模拟等国产替代方向的机遇。**

- **华为在2026全联接大会上宣布昇腾960系列芯片提前完成研发并性能翻倍，同步披露970、980路线图及业界首个NPO光引擎超节点。**9月17日，在2026年度华为全联接大会上，华为轮值董事长汪涛宣布昇腾960系列芯片已提前完成研发准备，整体性能翻倍，并首次披露昇腾970、980路线图。其中昇腾960DT提前至2027年Q1推出（较原规划提前三个季度），算力翻倍提升至2 PFLOPS（FP8）/4 PFLOPS（FP4），互联带宽为2.2TB/s，访存容量翻倍到288GB、带宽达到9.6TB/s；昇腾960PR定于2027年Q3发布，FP4算力提升至8 PFLOPS，但访存降至192GB、带宽2.4TB/s。后续昇腾系列芯片还将维持每年迭代一代的技术演进节奏，其中昇腾970芯片将于2028年推出，昇腾980计划2029年推出。昇腾970算力将提升至3.6 PFLOPS（FP8）/14 PFLOPS（FP4），访存容量为288GB，互联带宽4.4TB/s；昇腾980算力提升至7.2 PFLOPS（FP8）/28 PFLOPS（FP4），访存容量为384GB，互联带宽提高到8TB/s。四款芯片均延续SIMD/SIMT微架构并支持FP32/HF32/FP16/BF16/FP8/MXFP8/HiF8/MXFP4/HiF4等数据格式。此外，华为同步发布业界首个采用NPO（近封装光学）光引擎的超节点，基于“灵衢UnifiedBus+Hi-ONE”架构，其中Atlas960液冷超节点计划2027年Q3上市，Atlas860风冷超节点2027年Q2上市。汪涛表示昇腾超节点已累计部署超1000套，昇腾950超节点已开始规模商用。

- **长鑫科技9月20日宣布第五代DRAM工艺技术平台（G5平台）正式量产，工艺水平比肩行业顶尖量产节点。**G5平台通过四重曝光技术将内存阵列有源区半间距微缩至11.95纳米，存储电容深宽比达45:1，并开发适配DRAM的HKMG工艺将核心功能区高度缩小至6762纳米，每片晶圆产出裸片数量较第四代平台提升至少50%。同步展出两款基于G5平台的LPDDR5X量产产品，单颗容量均为24Gb、较上代提升50%，其中最高速率10667Mbps的国产高速LPDDR5X首次实现量产落地，已搭载于努比亚NaviX Ultra并进入规模量产阶段。此外，长鑫LPDDR6已于今年8月量产，峰值速率12800Mbps、最高容量16GB，首批搭载于小米18 Fold，为全球LPDDR6首次落地商用，标志着中国存储企业首次在高端内存标准上打破海外厂商长期垄断产品首发的局面。G5平台实现量产，将有助于公司进一步丰富产品矩阵、提升核心竞争力并巩固市场地位。但作为全新平台，其良率爬坡仍需一定周期，相关产品尚未形成规模销售，且新产品导入客户需经过验证与认证流程，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

- **电子行业本周跑赢大盘。**本周沪深300指数下跌0.06%，申万电子指数上涨6.06%，跑赢大盘6.12点，涨跌幅在申万一级行业中排第1位，PE(TTM)63.58倍。截至9月18日，申万电子二级子板块涨跌：半导体(+8.19%)、电子元器件（+1.32%）、光学光电子(+7.59%)、消费电子(+2.06%)、电子化学品(+9.93%)、其他电子(+5.07%)。海外方面，台湾电子指数上涨2.75%，费城半导体指数上涨0.83%。

下载日志已记录，仅供内部参考

- **投资建议：行业需求在AI驱动下依然较为旺盛，且供给端产能布局缓慢，高景气度或继续持续。目前存储价格过高对手机类消费电子需求压制或较为显著，当前估值也处于历史高分位水平。综合考虑，我们认为AI基建高景气或持续，半导体国产化依然加速发展，全球半导体估值处于较高分位，但资金流入显著，建议逢低关注AI与国产化的结构性机会为主。**建议关注：（1）AI创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪、海光信息、澜起科技、摩尔线程、沐曦股份、龙芯中科；光器件关注源杰科技、长光华芯、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、东山精密；PCB板块关注胜宏科技、沪电股份、深南电路、生益科技等；存储关注江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正；服务器与液冷关注英维克、中石科技、飞荣达、思泉新材、工业富联。（2）受益海内外需求强劲AIOT领域的乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、中科蓝讯、炬芯科技、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、泰凌微。（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、富创精密、新莱应材、中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材。（4）价格触底复苏的龙头标的，关注功率板块的新洁能、扬杰科技、东微半导；CIS的豪威集团、思特威、格科微；模拟芯片的圣邦股份、思瑞浦、美芯晟、芯朋微等。
- **风险提示：（1）下游需求复苏不及预期风险；（2）国产替代进程不及预期风险；（3）AI资本开支不及预期风险。**

下载日志已记录，仅供内部参考

正文目录

1. 行业新闻 5

2. 上市公司重要公告 7

3. 周行情回顾 8

4. 行业数据追踪 11

5. 风险提示 13

下载日志已记录，仅供内部参考

图表目录

图 1 申万一级行业指数周涨跌幅（%）.....8
图 2 申万行业二级板块指数涨跌幅（截至 2026/9/18）.....8
图 3 申万行业二级板块指数估值（截至 2026/9/18）.....8
图 4 电子指数组合图（截至 2026/9/18）.....9
图 5 申万三级细分板块周涨跌幅（%）.....9
图 6 本周电子行业各子版块涨跌幅前三个股.....10
图 7 本周美股主要科技股信息更新（截至 2026/9/18）.....10
图 8 2024 年 9 月 18 日-2026 年 9 月 18 日 DRAM 现货平均价（美元）.....11
图 9 2024 年 1 月-2026 年 7 月 NAND FLASH 合约平均价（美元）.....11
图 10 2023 年 9 月 15 日-2026 年 9 月 15 日 LPDDR4/4X 市场平均价（美元）.....12
图 11 2023 年 9 月 5 日-2026 年 9 月 7 日 TV 面板价格（美元）.....12
图 12 2022 年 9 月-2026 年 9 月笔记本面板价格（美元）.....12
图 13 2022 年 9 月-2026 年 9 月显示面板价格（美元）.....12

表 1 上市公司重要公告.....7

下载日志已记录，仅供内部参考

1.行业新闻

1）华为发布 AI 时代计算架构

9 月 17 日，华为发布 AI 时代的全新计算架构-Peerium 计算架构。华为称，该架构能实现百万级处理器成为一台计算机，以满足不断发展的 AI 算力需求。据华为介绍，Peerium 计算架构是基于嵌套并行，统一内存寻址、平等互联实现百万级处理器强扩展的计算架构。灵衢是实现 Peerium 计算架构的关键互联技术。灵衢是基于一个开放协议，可无限扩展地联接 CPU、NPU、内存、SSD、网卡和交换机的高速总线。有了灵衢，可实现计算、存储和网络的平等互联。华为表示，Atlas950 超节点是 Peerium 计算架构的首代产品，25.6 万卡 Atlas950 超节点集群已经在部署中。（信息来源：同花顺财经）

2）长鑫科技官宣第五代技术平台实现量产

作为国产内存龙头，长鑫科技 9 月 20 日在世界制造业大会上宣布重大突破，第五代 DRAM 技术平台(简称“G5 平台”)实现量产。依托创新的四重曝光技术把内存阵列的有源区半间距微缩至 11.95 纳米，接近全球最顶尖的内存量产平台制程。在 G5 微缩工艺突破背景下，存储密度实现跨越式提升，即每片晶圆产出裸片(8Gb 颗粒基准)数量较第四代平台提升至少 50%，在产品能效、成本控制上均具备显著优势。（信息来源：同花顺财经）

3）“第二代豆包手机”努比亚 NaviX Ultra 发布

9 月 16 日，俗称“第二代豆包手机”、搭载“豆包手机助手消费者版”的努比亚 NaviX Ultra 正式上市。该产品支持随时打断、连续对话，可识别粤语、闽南语、上海话等十余种方言及多语种。“能干活”是该产品的核心卖点。用户只需一句指令，即可触发跨应用任务，如代发飞书消息、预约会议、总结群消息、转发文档等。在锁屏状态下，任务仍可持续执行，支持数百步、数十分钟的长链路操作。办公场景新增工作任务模式，一句话即可生成代码、文档、PPT；录音纪要则引入飞书妙记能力。此外，出行、音乐、地图等第三方服务生态也已接入。用户授权后，手机可记住用户的偏好与习惯，构建个人记忆库，并支持通过语音保存屏幕内容、以自然语言检索本地信息。（信息来源：同花顺财经）

4）阿斯麦计划 2028 年生产超 110 台 EUV 光刻机

摩根大通分析师在会见阿斯麦首席财务官后表示，受人工智能需求持续强劲驱动，阿斯麦正研究于 2028 年生产超过 110 台极紫外光刻（EUV）设备。阿斯麦 7 月披露，其 2026 年低数值孔径 EUV 光刻机产能约为 65 台，计划 2027 年提升 30%，2028 年再提升 30%。该公司明年产能已全部售罄，预计至少供应 80 台设备。当前主要瓶颈为设备组装速度，而非供应链限制。多数新订单已排期至 2028 年。英特尔预计将于 2027 年重新成为阿斯麦重要客户，马斯克旗下 Terafab 项目等新客户亦在积极开发中。下一代高数值孔径 EUV 光刻机将于 2028 年开始推广，客户包括英特尔、三星电子和 SK 海力士；其中英特尔已在 18A 工艺中提前采用该设备，三星与 SK 海力士计划于 2028 年启用，台积电则规划于 2030 年投入使用。（信息来源：同花顺财经）

5）夏普将开展 AI 服务器业务

夏普公司 9 月 15 日宣布将开展 AI 服务器业务，2027 年度起将在日本销售鸿海生产的服务器，力争到 2030 年度实现 2500 亿日元（约合人民币 108 亿元）规模的销售额，还考虑未来在日本国内生产。夏普计划面向研究机构和数据服务器运营商销售两款搭载英伟达图形处理器（GPU）的机型。该公司今后还将探讨与鸿海联合生产。（信息来源：同花顺财经）

6）Anthropic 签署澳大利亚首份数据中心租赁协议，规划容量 2.16 吉瓦

下载日志已记录，仅供内部参考

人工智能巨头 Anthropic 已签署其在澳大利亚的首份数据中心租赁协议，借势有利的政治环境和丰富的新能源资源，锁定数据中心容量。该租赁协议涵盖的数据中心园区规划总容量达 2.16 吉瓦，与目前全球部分最大规模的运营数据中心相当。该拟建设施位于距离布里斯班约 250 公里的农田上，计划于 2027 年开始投入运营。继 OpenAI 去年就悉尼数据中心达成购电协议后，此项交易使 Anthropic 成为最新一家在澳大利亚站稳脚跟的人工智能巨头。（信息来源：同花顺财经）

7）Meta 拟明年上半年部署新款自研 ARKE 芯片

Meta 计划于明年上半年开始在数据中心部署其新款自研 ARKE 芯片，该公司表示，此举将在运行人工智能模型时节省成本和能源。公司早于 2023 年首次宣布了自主研发 AI 芯片的计划，目前正在测试该系列的第三代产品，代号为 MTIA 450，或称 Arke。下一代产品，代号 500，或称 Astrid，将在约一个月内完成设计工作，并于 2027 年底投入数据中心使用。Meta 预计未来会更广泛地采用这一产品。（信息来源：同花顺财经）

8）投资近 200 亿美元，美日拟共建晶圆厂

据《日经亚洲》9 月 17 日报道，日本与美国政府正就在美国境内共建一座晶圆厂展开磋商。该项目预计将成为两国此前达成的 5500 亿美元对美投资协议中的第三批重点推进项目，标志着日美产业合作从能源基础设施领域首次向芯片制造业延伸。该晶圆厂的预计投资规模介于 2 万亿至 3 万亿日元（约合 128.5 亿至 192.7 亿美元）之间，运营方拟由美国晶圆代工企业格罗方德（GlobalFoundries）担任，生产方向聚焦于用于运算处理的逻辑半导体。（信息来源：同花顺财经）

9）苹果接受三星涨价方案，iPhone 或将于 2027 年再度提价

9 月 18 日消息，据 gsmarena 报道称，苹果公司已与三星电子就 2027 年第一季度存储芯片采购价格达成协议，接受 DRAM（动态随机存取存储器）和 NAND 闪存的涨价方案。此举意味着 iPhone 等产品在 2027 年面临进一步涨价压力。根据产业链消息，苹果将从 2027 年第一季度起，以接近 2 美元/Gb 的价格采购 LPDDR5X 内存，以接近 0.33 美元/Gb 的价格采购 NAND 闪存。作为对比，三星 2026 年第三季度对苹果的报价分别为：LPDDR5X 约 1.5 美元/Gb，NAND 闪存约 0.26 美元/Gb。据此测算，DRAM 采购价格涨幅约 33%，NAND 闪存涨幅约 27%，整体涨幅在 30%至 40%区间。（信息来源：同花顺财经）

10）SEMICON India 2026 开幕，应材、泛林均宣布在印投资计划

9 月 17 日，年度半导体产业展览会 SEMICON India 在印度首都新德里开幕。本次活动主体为“从芯片到系统：构建生态希望”，吸引超 600 家企业参与，将持续到 9 月 19 日。两大半导体制造设备领域企业应用材料(Applied Materials)、泛林研究(Lam Research)均在活动前夕公布了在印度的投资计划。应用材料计划未来 10 年在卡纳塔克邦班加罗尔商业园区投资 360 亿卢比，用于研发、关键设备制造、半导体制造领域软件开发，这笔投资预计将创造 1000 个岗位。泛林研究则计划斥资 1,000 亿卢比建设其首个在印硅锭生产据点，并扩大其在印先进研发业务、培养印度半导体人才。（信息来源：同花顺财经）

下载日志已记录，仅供内部参考

2.上市公司重要公告

表1 上市公司重要公告

公司名称	公告类型	公司公告
赛微电子 300456.SZ	对外投资	公司全资子公司微芯科技拟与华芯荣观、盛世鸿元、高端装备制造产业基金、南山弘基、宁波产投签署《合伙协议》，共同投资设立安徽荣观甬科创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）。其中微芯科技拟以自有资金出资 1.44 亿元，占合伙企业出资额的 28.80%。
芯源微 688037.SH	限售股上市	公司本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 33.38 万股，上市流通总数为 33.38 万股；上市流通日期为 2026 年 9 月 21 日。
恒玄科技 688609.SH	股份回购	2026 年 9 月 16 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 5 万股，占公司目前总股本 2.37 亿股的比例为 0.0211%，回购成交的最高价为 94.94 元/股，最低价为 92.21 元/股（回购成交价格以实时成交股价为准），支付的资金总额为人民币 466.98 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
全志科技 300458.SZ	股权激励	公司拟向激励对象授予第二类限制性股票 440 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 825,427,382 股的 0.53%，其中首次授予 428.50 万股，预留 11.50 万股，本激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）为 30.47 元/股。
福光股份 688010.SH	对外投资	为提升公司精密光学元件制造能力，公司拟使用部分剩余募集资金 8,035.36 万元用于投资建设精密光学元件项目。为把握低空经济、航天、高端工业及消费光学国产替代的发展机遇，提升公司高端光学镜头研发能力，进一步布局系统级产品，公司拟使用部分剩余募集资金 3,000.00 万元用于空天镜头研发项目。
蓝思科技 300433.SZ	对外投资	公司拟作为有限合伙人参与投资厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）。合伙企业认缴出资总额人民币 49.00 亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2.00 亿元，占合伙企业认缴出资总额的 4.0816%。
骏成科技 301106.SZ	高管变动	公司董事会于近日收到独立董事赵珊女士递交的书面辞职报告，赵珊女士因个人职业规划原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，辞职后赵珊女士将不再担任公司任何职务，其原定任期至公司第四届董事会届满之日。
天承科技 688603.SH	筹划发行 H 股	为深入实施全球化战略，打造国际化资本运作平台，充分借助国际资本市场拓宽多元融资渠道，进一步增强公司综合竞争力、提升国际影响力，公司正在筹划发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所挂牌上市。
弘信电子 300657.SZ	向特定对象发行股票	公司向特定对象发行股票：发行对象为实际控制人李强，以现金认购 810.23 万股，发行价格为 28.14 元/股，募集资金约 2.28 亿元，限售期 18 个月。
长川科技 300604.SZ	筹划发行 H 股	为推进全球化战略布局，加快海外业务发展，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，打造国际化资本运作平台，公司拟发行 H 股并申请在香港联交所主板上市。

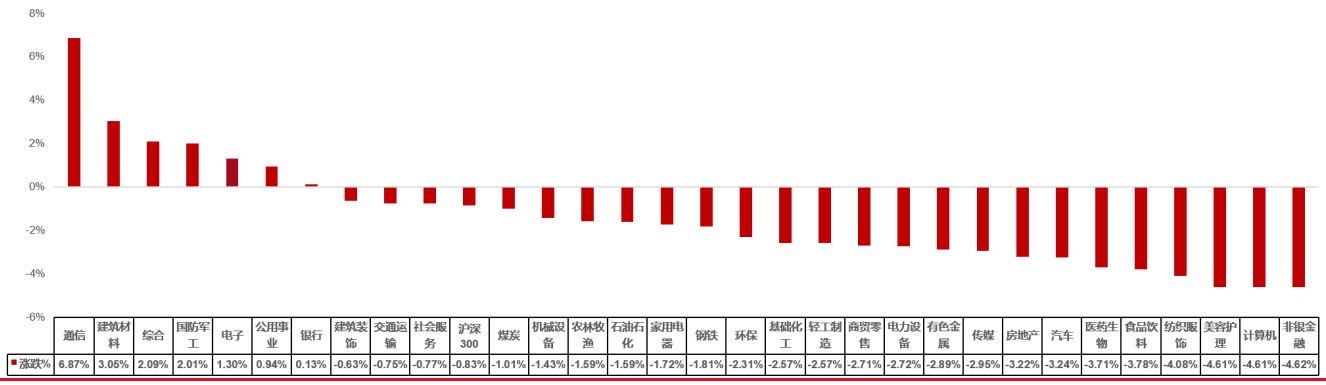
资料来源：同花顺，东海证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

3.周行情回顾

本周沪深 300 指数下跌 0.06%，申万电子指数上涨 6.06%，跑赢大盘 6.12 点，涨跌幅在申万一级行业中排第 1 位，PE(TTM)63.58 倍。

图1 申万一级行业指数周涨跌幅（%）



	通信	建筑材料	综合	国防军工	电子	公用事业	银行	建筑装饰	交通运输	社会服务	沪深300	煤炭	机械设备	农林牧渔	石油石化	家用电器	钢铁	环保	基础化工	轻工制造	商贸零售	电力设备	有色金属	传媒	房地产	汽车	医药生物	食品饮料	纺织服饰	美容护理	计算机	非银金融
涨跌%	6.87%	3.05%	2.09%	2.01%	1.30%	0.94%	0.13%	-0.63%	-0.75%	-0.77%	-0.83%	-1.01%	-1.43%	-1.59%	-1.59%	-1.72%	-1.81%	-2.31%	-2.57%	-2.57%	-2.71%	-2.72%	-2.89%	-2.95%	-3.22%	-3.24%	-3.71%	-3.78%	-4.08%	-4.61%	-4.61%	-4.62%

资料来源：Wind，东海证券研究所

截至 9 月 18 日，申万电子二级子板块涨跌：半导体(+8.19%)、电子元器件（+1.32%)、光学光电子(+7.59%)、消费电子(+2.06%)、电子化学品(+9.93%)、其他电子(+5.07%)。海外方面，台湾电子指数上涨 2.75%，费城半导体指数上涨 0.83%。

图2 申万行业二级板块指数涨跌幅（截至 2026/9/18）

2026/9/18 指数	代码	板块	收盘价	涨跌幅 周涨跌幅	30日涨跌幅	年初至今
申万电子二级指数	801081.SI	半导体	10,010.16	8.19%	-6.80%	44.02%
	801083.SI	电子元器件	23,904.03	1.32%	1.04%	74.83%
	801084.SI	光学光电子	1,868.87	7.59%	-4.91%	12.12%
	801085.SI	消费电子	10,111.03	2.06%	-4.66%	0.66%
	801086.SI	电子化学品	12,361.93	9.93%	-7.91%	61.64%
	801082.SI	其他电子	17,239.46	5.07%	-2.36%	10.41%
大盘指数	000001.SH	上证指数	3,911.87	0.61%	-1.97%	-1.44%
	399001.SZ	深证成指	13,640.87	1.26%	-6.71%	0.86%
	399006.SZ	创业板指	3,372.68	1.52%	-8.98%	5.29%
	000300.SH	沪深300	4,507.39	-0.06%	-4.62%	-2.65%
行业指数	801080.SI	电子(申万)	8,935.03	6.06%	-5.03%	36.33%
	TWSE071.TW	台湾电子指数	1,601.01	2.75%	5.64%	74.53%
	SOX.GI	费城半导体指数	11,921.69	0.83%	-0.59%	68.31%

资料来源：Wind，东海证券研究所

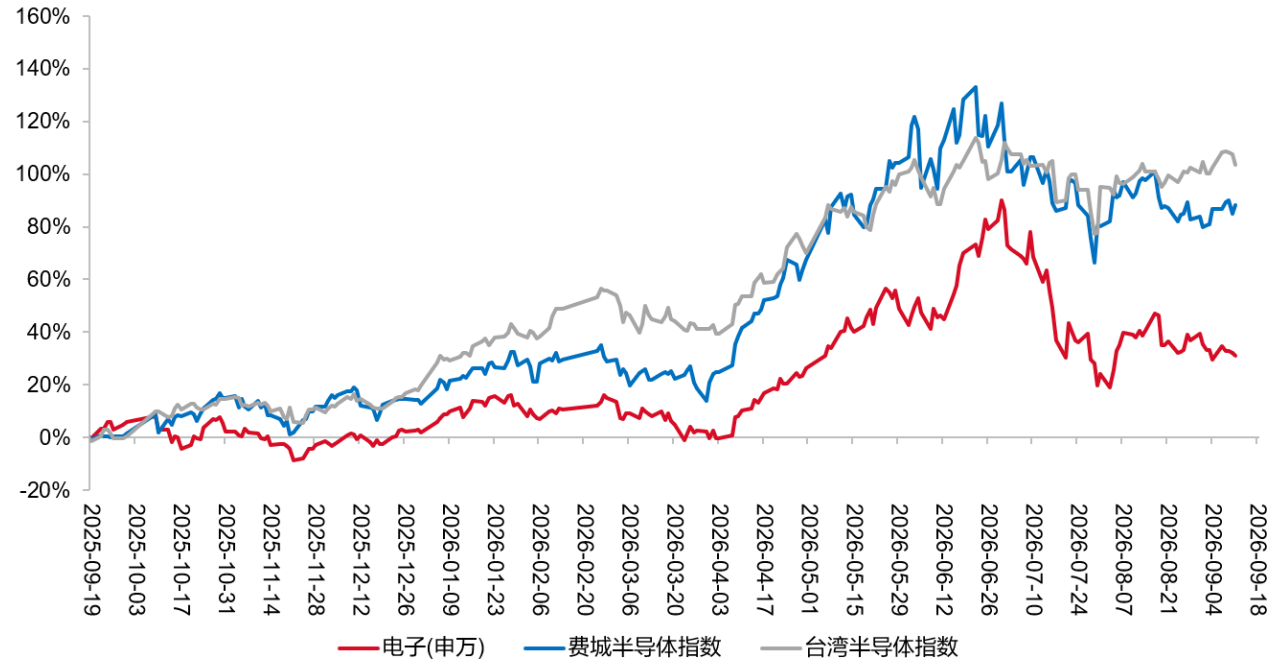
图3 申万行业二级板块指数估值（截至 2026/9/18）

2026/9/18 指数	代码	板块	PE估值 PE（TTM）	历史分位数（5y）	历史分位数（10y）	PS估值 PS（TTM）	历史分位数（5y）	历史分位数（10y）	PB估值 PB（MRQ）	历史分位数（5y）	历史分位数（10y）
申万电子二级指数	801081.SI	半导体	77.42	58.43%	52.53%	14.76	93.97%	96.99%	16.35	88.06%	90.84%
	801083.SI	电子元器件	71.69	93.14%	96.58%	7.84	95.87%	97.94%	11.67	95.00%	97.51%
	801084.SI	光学光电子	52.63	55.37%	65.13%	1.88	96.20%	68.96%	6.79	96.40%	82.61%
	801085.SI	消费电子	35.61	77.69%	56.59%	1.42	71.74%	42.24%	7.22	78.68%	48.95%
	801086.SI	电子化学品	97.64	94.55%	97.28%	9.60	94.96%	95.51%	8.55	96.32%	96.93%
	801082.SI	其他电子	42.05	26.36%	34.01%	1.33	61.90%	62.78%	12.20	84.59%	89.87%
大盘指数	000001.SH	上证指数	15.79	78.35%	76.90%	1.47	83.64%	89.11%	5.25	70.62%	53.29%
	399001.SZ	深证成指	30.20	81.24%	78.18%	1.96	71.98%	53.07%	2.74	67.77%	51.79%
	399006.SZ	创业板指	38.41	51.74%	33.61%	4.03	50.99%	34.29%	5.37	64.55%	62.87%
	000300.SH	沪深300	13.38	74.30%	64.06%	1.50	79.01%	82.91%	6.04	58.72%	38.84%
行业指数	801080.SI	电子(申万)	63.58	81.61%	85.65%	4.82	95.70%	97.86%	13.10	94.38%	97.20%
	SOX.GI	费城半导体指数	36.73	43.54%	66.06%	15.43	91.15%	94.69%	14.60	93.62%	96.17%

资料来源：Wind，东海证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

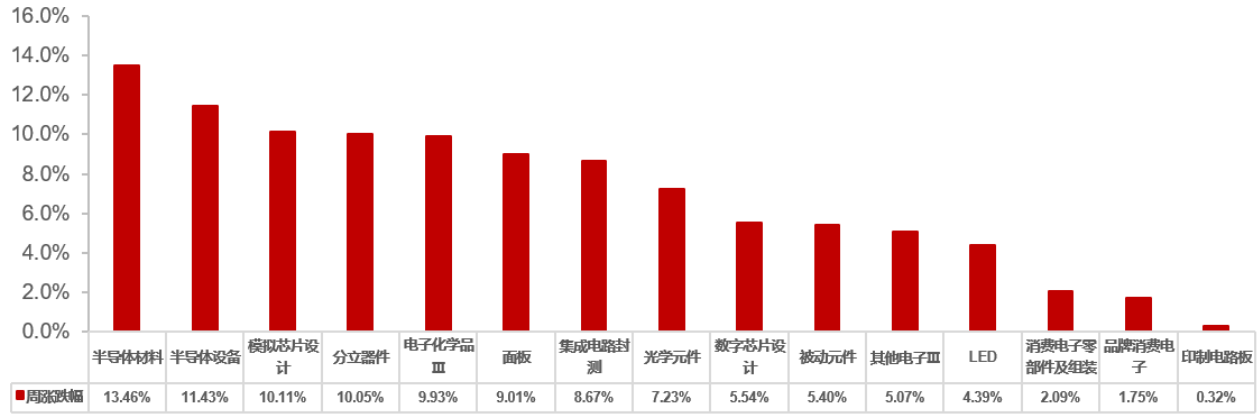
图4 电子指数组合图（截至 2026/9/18）



资料来源：Wind，东海证券研究所

本周半导体细分板块涨跌幅分别为：半导体材料（+13.46%）、半导体设备（+11.43%）、模拟芯片设计（+10.11%）、分立器件（+10.05%）、电子化学品Ⅲ（+9.93%）、面板（+9.01%）、集成电路封测（+8.67%）、光学元件（+7.23%）、数字芯片设计（+5.54%）、被动元件（+5.40%）、其他电子Ⅲ（+5.07%）、LED（+4.39%）、消费电子零部件及组装（+2.09%）、品牌消费电子（+1.75%）、印制电路板（+0.32%）。

图5 申万三级细分板块周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，东海证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

图6 本周电子行业各子版块涨跌幅前三个股

大类	证券代码	分类	证券名称	周涨跌幅前三	30日涨跌幅
半导体	003026.SZ	半导体材料	中晶科技	36.71%	19.04%
	688361.SH	半导体设备	中科飞测	26.81%	3.87%
	688432.SH	半导体材料	有研硅	25.65%	14.83%
	600745.SH	分立器件	*ST闻泰	-2.28%	-2.33%
	688593.SH	数字芯片设计	新相微	-0.22%	-12.63%
	603991.SH	半导体设备	领先股份	1.85%	27.94%
电子元器件	605058.SH	印制电路板	澳弘电子	42.30%	69.71%
	301251.SZ	印制电路板	威尔高	30.64%	58.60%
	301132.SZ	印制电路板	满坤科技	23.95%	57.09%
	920821.BJ	印制电路板	则成电子	-16.45%	14.15%
	920128.BJ	被动元件	胜业电气	-11.00%	6.21%
	603228.SH	印制电路板	景旺电子	-6.53%	6.69%
光学光电子	300939.SZ	面板	秋田微	34.26%	41.03%
	920438.BJ	光学元件	戈碧迦	24.88%	-15.49%
	688378.SH	光学元件	奥来德	23.01%	3.11%
	688538.SH	面板	和辉光电	-6.36%	-11.59%
	300269.SZ	LED	联建光电	-4.93%	-5.70%
	300076.SZ	面板	*ST宁视	-3.42%	-6.42%
消费电子	603626.SH	消费电子零部件及组装	科森科技	29.11%	38.42%
	688678.SH	消费电子零部件及组装	福立旺	20.92%	23.22%
	300868.SZ	消费电子零部件及组装	杰美特	19.81%	-3.32%
	920857.BJ	消费电子零部件及组装	泓禧科技	-7.12%	-5.34%
	002855.SZ	消费电子零部件及组装	捷荣技术	-5.49%	25.37%
	002600.SZ	消费电子零部件及组装	领益智造	-3.97%	-2.78%
其他电子Ⅲ	300656.SZ	其他电子Ⅲ	民德电子	31.02%	7.20%
	688103.SH	其他电子Ⅲ	国力电子	16.60%	2.50%
	002388.SZ	其他电子Ⅲ	新亚制程	16.43%	16.05%
	002161.SZ	其他电子Ⅲ	远望谷	-9.83%	21.04%
	002130.SZ	其他电子Ⅲ	沃尔核材	-4.41%	0.53%
	300650.SZ	其他电子Ⅲ	太龙股份	-0.49%	0.74%
电子化学品Ⅲ	002584.SZ	电子化学品Ⅲ	西陇科学	25.32%	18.18%
	688548.SH	电子化学品Ⅲ	广钢气体	18.35%	-19.22%
	300398.SZ	电子化学品Ⅲ	飞凯材料	16.92%	-0.13%
	920526.BJ	半导体材料	凯华材料	5.01%	-8.15%
	002643.SZ	电子化学品Ⅲ	万润股份	5.46%	-5.98%
	300481.SZ	电子化学品Ⅲ	濮阳惠成	5.83%	-6.42%

资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

我们选取了较有代表性的部分美股科技股，并将相关信息更新如下。本周涨幅较大的为超威半导体（+8.46%）、英特尔（+5.50%）、日月光投控（+5.47%）。

图7 本周美股主要科技股信息更新（截至 2026/9/18）

证券代码	证券简称	所属GICS子行业	市值（亿美元）	周涨跌幅	月涨跌幅	年涨跌幅	PE (TTM)	PB (MRQ)	营收（亿美元）						归母净利润（亿美元）					
									2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
AMD.O	超威半导体	数字芯片设计	10048.21	8.46%	30.76%	187.41%	156.17	14.95	74.38	76.85	92.46	102.70	102.53	115.36	7.09	8.72	12.43	15.11	13.83	22.97
INTC.O	英特尔	数字芯片设计	6437.42	5.50%	36.05%	230.03%	-57.02	7.35	126.67	128.59	136.53	136.74	135.77	161.28	-8.21	-29.18	40.63	-5.91	-37.28	-110.33
ASX.N	日月光投控	集成电路封测	977.49	5.47%	18.35%	173.84%	51.21	8.00	44.07	50.94	54.70	56.72	53.47	59.17	2.35	2.63	3.73	4.79	4.54	6.61
MU.O	美光科技	数字芯片设计	11790.41	4.16%	8.89%	265.99%	23.36	16.27	80.53	93.01	113.15	136.43	238.60	414.56	15.83	18.85	32.01	52.40	137.85	282.43
ARM.O	Arm Holdings	数字芯片设计	3448.57	4.09%	33.48%	195.40%	330.32	46.56	12.41	10.53	11.35	12.42	14.90	12.89	2.10	1.30	2.38	2.23	3.13	2.70
GOOGL.O	谷歌A	互动媒体与服务IV	43412.83	3.26%	4.67%	13.63%	17.78	6.78	902.34	964.28	1023.46	1138.28	1098.96	1197.96	345.40	281.96	349.79	344.55	625.78	223.59
NVDA.O	英伟达	数字芯片设计	54798.58	1.82%	3.10%	22.20%	28.41	54.73	440.62	467.43	570.06	681.27	816.15	962.21	187.75	264.22	319.10	429.60	583.21	596.88
AAPL.O	苹果	手机	49471.35	1.16%	6.96%	25.03%	38.37	46.46	953.59	940.36	1024.66	1437.56	1111.84	1094.17	247.80	234.34	274.66	420.97	295.78	297.89
TSM.N	台积电	集成电路制造	23087.07	0.54%	7.41%	47.39%	32.87	11.43	255.81	321.93	330.97	332.04	353.54	402.01	110.21	137.31	151.04	160.53	178.46	223.59
LITE.O	Lumentum控股	通信设备IV	856.18	0.42%	4.34%	158.96%	-12.35	101.13	4.25	4.81	5.34	6.66	8.08	10.06	-0.44	2.13	0.04	0.78	1.43	-71.62
MSFT.O	微软	办公软件	37247.28	-0.37%	-1.12%	4.38%	27.85	9.53	700.66	764.41	776.73	812.73	828.86	900.07	258.24	272.33	277.47	384.58	317.78	357.66
TXN.O	德州仪器	模拟芯片设计	2473.71	-0.77%	3.82%	58.76%	41.11	13.74	40.69	44.48	47.42	44.23	48.25	54.63	11.73	12.88	13.56	11.56	15.36	19.69
ADI.O	亚德诺	模拟芯片设计	1855.89	-0.81%	5.76%	42.49%	44.88	5.50	24.23	26.40	28.80	30.76	31.60	36.23	3.91	5.70	5.19	7.88	8.31	11.76
ASML.O	阿斯麦	半导体设备	6573.18	-1.08%	0.90%	60.61%	54.12	26.41	83.58	90.53	88.20	114.05	100.98	106.48	25.42	26.96	24.93	33.33	31.75	33.31
AMZN.O	亚马逊	多品类零售IV	27877.23	-1.20%	-0.51%	11.97%	20.61	5.05	1556.67	1677.02	1801.69	2133.86	1815.19	2006.06	171.27	181.64	211.87	211.92	302.55	626.47
AVGO.O	博通	模拟芯片设计	17312.05	-1.21%	-1.90%	5.38%	45.24	19.74	149.16	150.04	159.52	180.15	193.11	221.87	55.03	49.65	41.40	85.18	73.49	93.10
ORCL.N	甲骨文	系统软件	4492.06	-1.78%	-0.38%	-23.05%	23.98	15.00	141.30	159.03	149.26	160.58	171.90	191.84	29.36	34.27	29.27	61.35	36.99	42.23
QCOM.O	高通	数字芯片设计	2039.87	-2.34%	14.55%	15.33%	22.03	7.48	109.79	103.65	112.70	122.52	105.99	99.47	28.12	26.66	-31.17	30.04	73.70	20.02
NXPI.O	恩智浦	模拟芯片设计	586.05	-3.21%	3.92%	8.48%	19.70	5.14	28.35	29.26	31.73	33.35	31.81	34.96	4.90	4.45	6.31	4.55	11.22	7.67
ON.O	安森美半导体	模拟芯片设计	279.22	-8.09%	-3.20%	32.45%	44.31	3.87	14.46	14.69	15.51	15.30	15.13	16.04	-4.85	1.70	2.55	1.82	-0.33	2.27

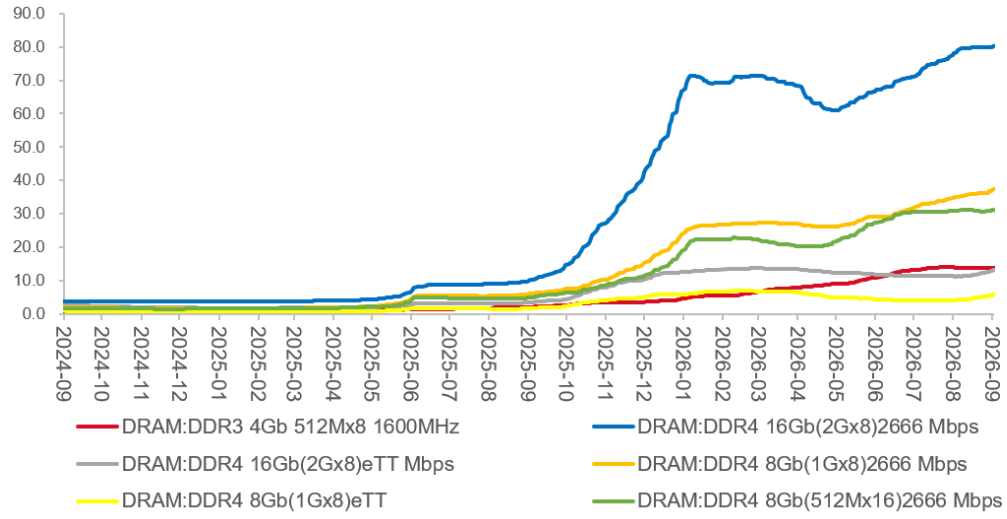
资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

4.行业数据追踪

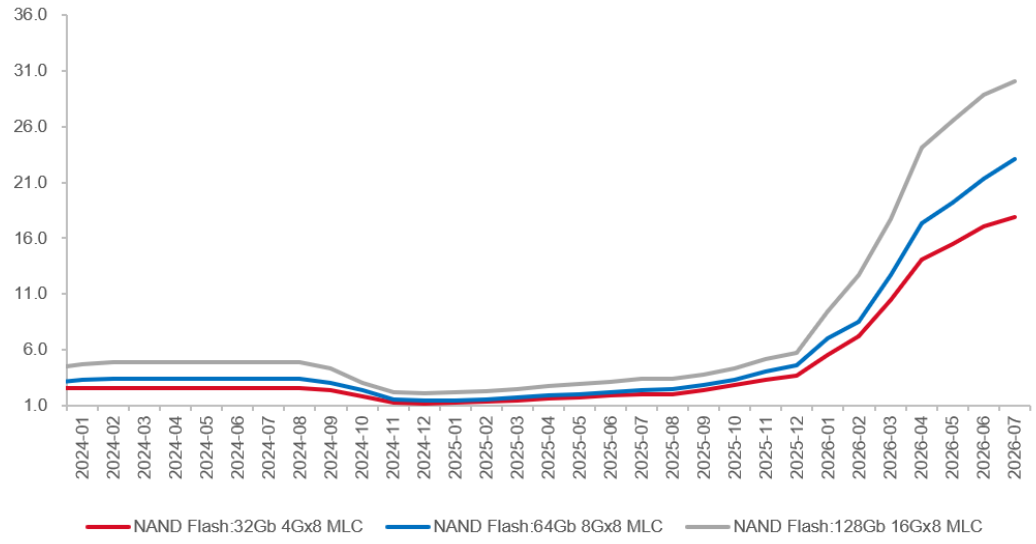
存储芯片价格自 2023 年下半年以来小幅度反弹，但自 2024 年 9 月起，DRAM 现货价格略有承压，部分 DRAM 细分产品价格自 2025 年 2 月中旬开始有所回升，波动上涨至 6 月，其中 6 月整体涨幅较大，DDR4 价格已升至 2022 年的前期高点，7 月起价格顶部震荡，9 月起部分产品价格持续上涨，2026 年 2 月起部分细分产品价格有所震荡，5 月起部分产品价格持续上涨。NAND Flash 合约价格在大幅下滑后于 2025 年 1 月回升，涨势已延续至 2026 年 7 月。

图8 2024 年 9 月 18 日-2026 年 9 月 18 日 DRAM 现货平均价（美元）



资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

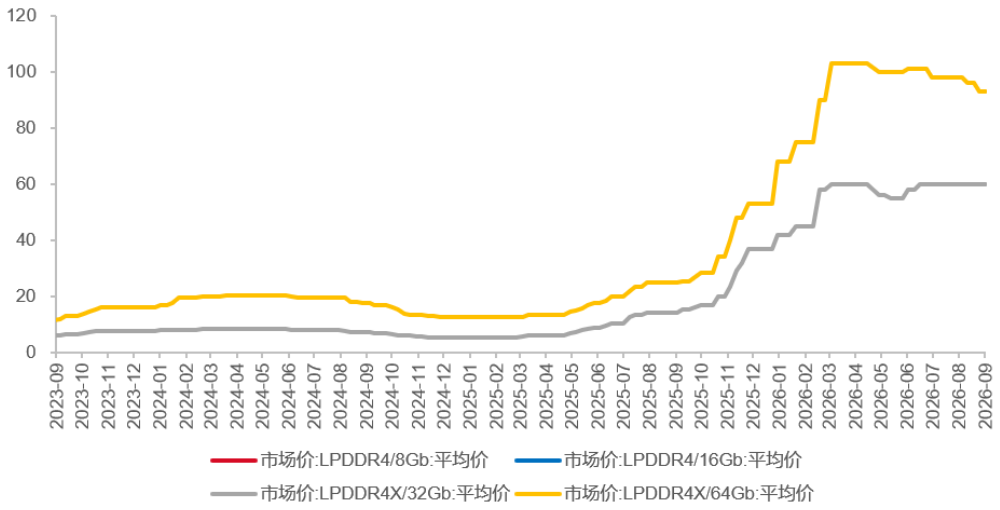
图9 2024 年 1 月-2026 年 7 月 NAND FLASH 合约平均价（美元）



资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

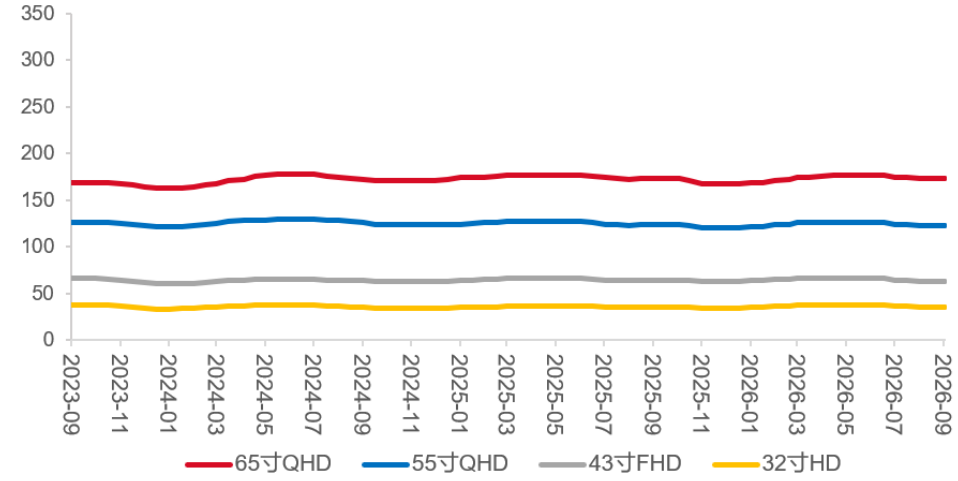
图10 2023 年 9 月 15 日-2026 年 9 月 15 日 LPDDR4/4X 市场平均价（美元）



资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

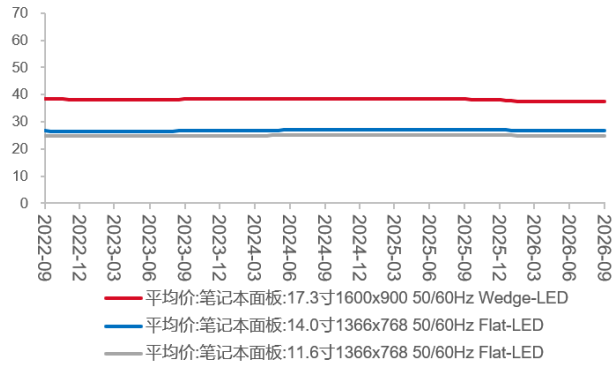
TV 面板、IT 面板价格逐渐稳定。

图11 2023 年 9 月 5 日-2026 年 9 月 7 日 TV 面板价格（美元）



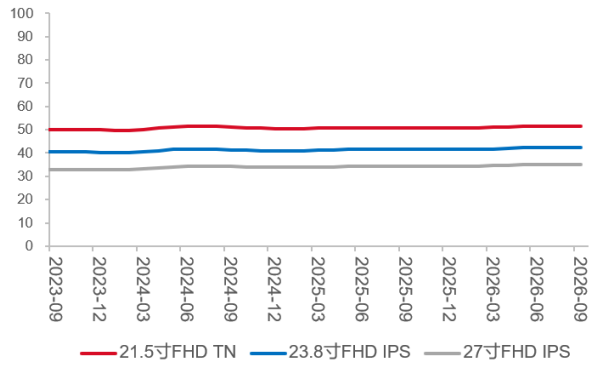
资料来源：集邦 Display，东海证券研究所

图12 2022 年 9 月-2026 年 9 月笔记本面板价格（美元）



资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

图13 2022 年 9 月-2026 年 9 月显示面板价格（美元）



资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

5.风险提示

（1）下游终端需求复苏不及预期风险：下游需求复苏程度不及预期可能导致相关企业库存积压或相关工程建设进度放缓，并可能再度影响产业链内部分企业的稼动率；

（2）国产替代进程不及预期风险：国际贸易摩擦和相关进出口管制进一步升级，可能导致相关设备、原材料、零部件、核心专利技术紧缺，若国内相关产品替代程度不及预期，或将影响国内半导体产业链；

（3）AI 资本开支不及预期风险：AI 算力需求为当前半导体增长核心，若宏观经济波动或 AI 应用商业化落地慢于预期，导致云厂商及下游企业资本开支收缩，或将直接影响 AI 芯片、HBM、先进封装等环节订单与业绩兑现节奏。

下载日志已记录，仅供内部参考

一、评级说明

	评级	说明
市场指数评级	看多	未来 6 个月内上证综指上升幅度达到或超过 20%
	看平	未来 6 个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间
	看空	未来 6 个月内上证综指下跌幅度达到或超过 20%
行业指数评级	超配	未来 6 个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过 10%
	标配	未来 6 个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	低配	未来 6 个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10%
公司股票评级	买入	未来 6 个月内股价相对强于上证指数达到或超过 15%
	增持	未来 6 个月内股价相对强于上证指数在 5%—15%之间
	中性	未来 6 个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	未来 6 个月内股价相对弱于上证指数 5%—15%之间
	卖出	未来 6 个月内股价相对弱于上证指数达到或超过 15%

二、分析师声明：

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证以专业严谨的研究方法和分析逻辑，采用合法合规的数据信息，审慎提出研究结论，独立、客观地出具本报告。

本报告中准确反映了署名分析师的个人研究观点和结论，不受任何第三方的授意或影响，其薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

署名分析师本人及直系亲属与本报告中涉及的内容不存在任何利益关系。

三、免责声明：

本报告基于本公司研究所及研究人员认为合法合规的公开资料或实地调研的资料，但对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告仅反映研究人员个人出具本报告当时的分析和判断，并不代表东海证券股份有限公司，或任何其附属或联营公司的立场，本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。在法律允许的情况下，本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告仅供“东海证券股份有限公司”客户、员工及经本公司许可的机构与个人阅读和参考。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何机构和个人的投资建议，任何形式的保证证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本公司客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。

本报告版权归“东海证券股份有限公司”所有，未经本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。

四、资质声明：

东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构，已经具备证券投资咨询业务资格。我们欢迎社会监督并提醒广大投资者，参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构，注意防范非法证券活动。

五、联系方式：

地址：上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦
网址：Http://www.longone.com.cn
座机：（8621）20333275
手机：18221956989
传真：（8621）50585608
邮编：200125